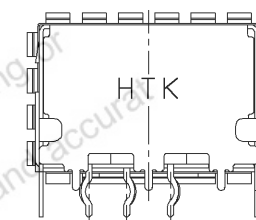


掲載している製品の特長及び仕様は参考値です。変更する場合があります。特性及び仕様についてのご注文の際は必ず変更を告知し、承認を待たせてください。採用のご検討やご注文の取り交わしをお手数ですがお問い合わせのうえ、納入仕様書の取り交わしをお願いします。

The product information in this data is for reference only. This is subject to change without notice. Please request Engineering Drawing for the most current and accurate design information. Contact our sales staff for further information before considering ordering any of our products.

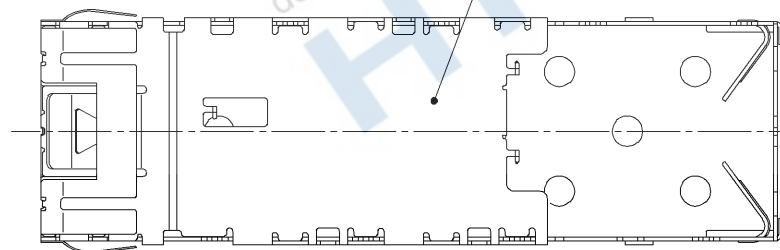


注1. 表面処理
 ケージ : めっき無し
 EMIスプリング : すずめっき

2. 基板厚 : 1.6mm以上

Note 1. Plating
 Cage : Non-plating.
 EMI spring : Tin plating.

2. P. C. B. thickness : 1.6mm min.



4	EMIスプリングB	りん青銅	1	注1参照	
	EMI spring B	Phosphor Bronze		See note.1	
3	EMIスプリングA	りん青銅	1	注1参照	
	EMI spring A	Phosphor Bronze		See note.1	
2	ケージB	洋白	1	注1参照	
	Cage B	Nickel Silver Alloy		See note.1	
1	ケージA	洋白	1	注1参照	
	Cage A	Nickel Silver Alloy	1	See note.1	

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
△3									
△2									
△1	Jan. 19 2012	M. K	Change Material Change Finish						

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
6.14 (2011)	2/1	mm (INCH)	3RD. A. P	製 図 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.
M. KASHIHARA	M. KASHIHARA			承 認 APP.	名 称 NAME	SFP+ ケージ (プレスインタイプ) Cage for SFP+ (Press-in type)
				H. EBIHARA	製 番 PART NO.	AKX-BCGP